

苏州市科技计划项目验收证书

苏科验字〔2020〕764号

计划类别：重点产业技术创新->产业联合创新

项目编号：3-2

项目名称：高性能氮化镓芯片封装与可靠性技术研究

承担单位：中科院微电子研究所昆山分所

主管部门：昆山市科学技术局

项目合作单位：

项目负责人：王英辉

项目组成员：Tadatomo SUGA、徐杨、曹治、王艳花、赫然

验收形式：会议验收

验收结论：验收通过

发证日期：

项目验收委员会名单：

姓名	单位	性别	专业	职务或职称
徐志军	解放军工程技术大学	男	电子信息	教授
李微	东南大学	男	软件工程	教授
郭旭红	苏州大学	男	机电一体化	教授
刘雯	西交利物浦大学	女	电子信息	副教授
戴军	昆山公信会计师事务所有限公司	男	会计学	注册会计师

项目验收意见：

2020 年 04 月 16 日，受苏州市科技局委托，昆山市科技局组织专家对中科院微电子研究所昆山分所承担的“高性能氮化镓芯片封装与可靠性技术研究”（项目编号：3-2）进行了验收，验收委员会听取了项目汇报，查阅了相关资料，经质询和讨论，形成验收意见如下：

1、项目承担单位提交的验收资料齐全、数据详实，符合验收要求。

2、项目开发基于铂催化甲酸气体还原微米氧化银及铜低温烧结互联的新工艺，键合强度大于 20 MPa，通过 ANSYS 软件模拟计算 ACP 封装热性能可提高 54%。

3、项目实施期间，申请发明专利 2 项、实用新型 1 项；其中，已授权实用新型 1 项。完成开发新工艺 1 项；培养一名博士生与一名硕士生。

4、项目实际完成新增投资 157.76 万元。新增投资中，苏州科技局支持经费 30 万元，昆山市地方配套资助 30 万元，单位自筹资金 97.76 万元。资金到位及时，使用合理。

验收委员会认为该项目完成了合同规定的各项任务 and 指标，一致同意该项目通过验收。